



北京同方微电子有限公司

THD20F06BC 非接触模块 制卡规范 版本 V1.0



修改记录

版本号	主要更改内容	编写者	发布日期	DCR No.
V1.0	建立文档		2010/12/20	

北京菱电创新科技有限公司



目录:

修改记录.....	- 2 -
1. 概述.....	- 4 -
1.1 简介.....	- 4 -
1.2 参考资料.....	- 4 -
2. 封装说明.....	- 5 -
2.1 模块概貌图及尺寸	- 5 -
3. 制卡说明.....	- 6 -
3.1 卡片天线.....	- 6 -
3.2 天线参数.....	- 6 -
3.3 环境要求.....	- 6 -

北京菱电创新科技有限公司



1. 概述

1.1 简介

本文档为 THD20F06BD-V10 非接触模块制卡规范，包括 THD20F06BD-V10 产品非接触模块参数，以及制卡说明。

本文档仅作为 THD20F06BD-V10 非接触式智能卡，封装指导，不做其他用途。

1.2 参考资料

ISO14443-TYPEA

ISO14443-TYPEB

《THD20F06BD 设计规范》

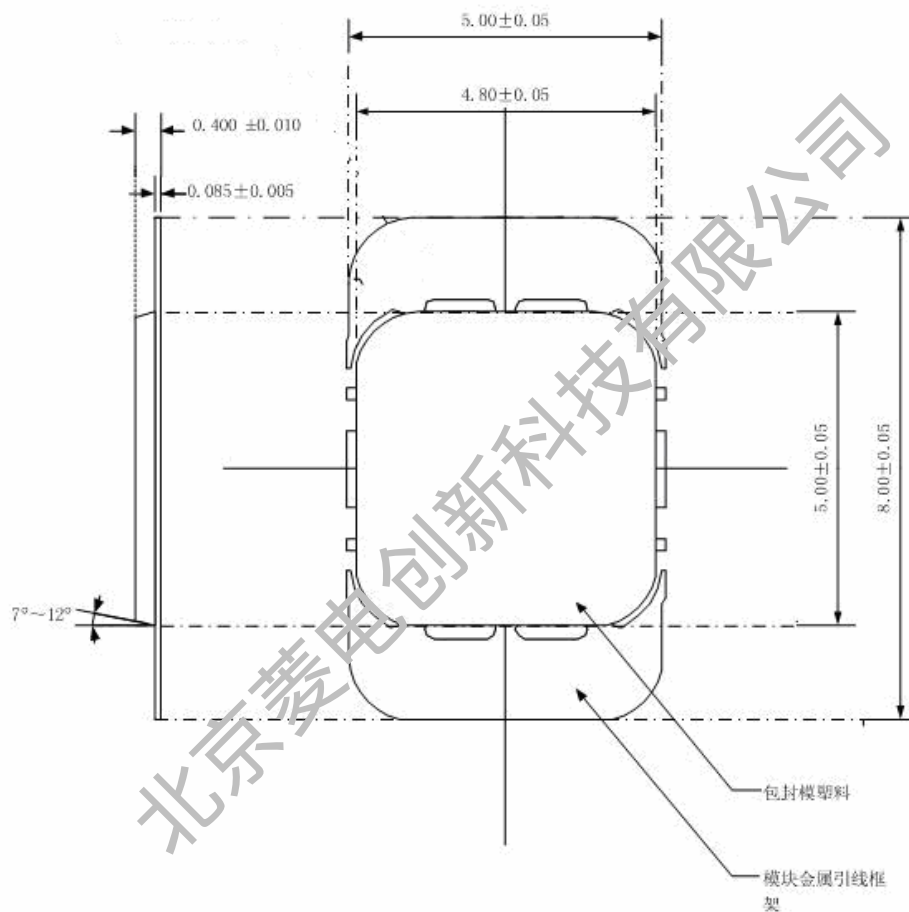
《THD20F06BD 产品规范》

《THD20F06BD-V10 谐振电容测试报告》

2. 封装说明

2.1 模块概貌图及尺寸

模块封装采用 X0A2 形式，由芯片、引线框架、金丝、粘片胶和模塑料组成，采用注塑封装的方法形成固定外形结构。模块外形图如下：

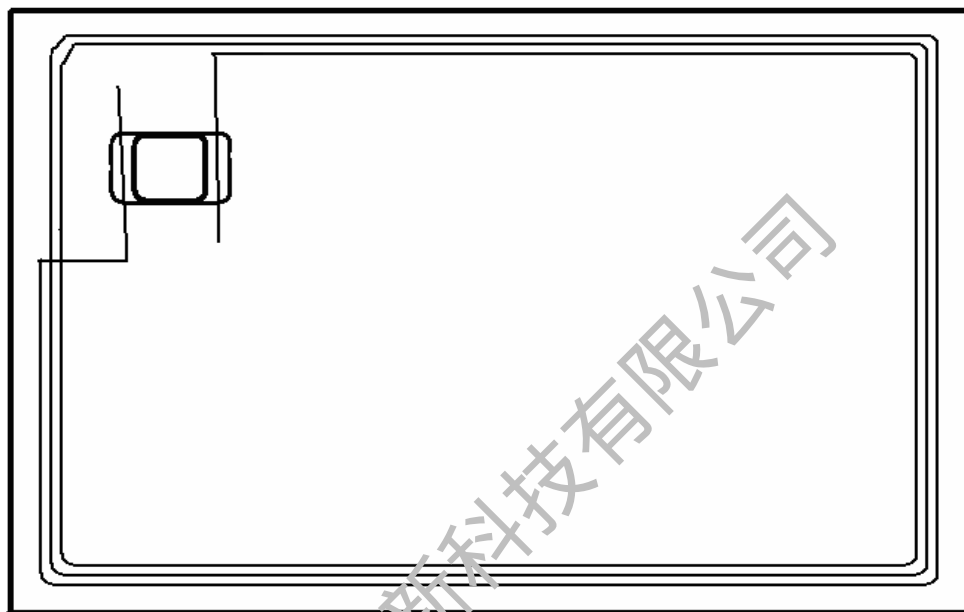


物理参数	数值			单位	备注
	最小	典型	最大		
模块包封 X 尺寸	4.75	4.80	4.85	mm	
模块包封 Y 尺寸	4.95	5.00	5.05	mm	
模块厚度	3.90	4.00	4.10	mm	
模块 X 偏移			0.075	mm	
模块 Y 偏移			0.075	mm	

3. 制卡说明

3.1 卡片天线

示意图如下：



3.2 天线参数

建议天线：
线圈长（外径）：79 mm
线圈宽（外径）：48 mm
线径：0.2 mm
线距：0.3 mm
匝数：3 圈线圈

实际做出的性能可能与预期有一些差距，需要制卡方在上面尺寸的基础上，在 10% 范围内进行微调，调整目标是谐振频率为 14.2MHz。

3.3 环境要求

封卡及层压过程中需要做好 ESD 的防护，做好接地（导体）和除静电（绝缘体）处理。